(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年9月4日(04.09.2025)

WIPO | PCT

(10) 国際公開番号
WO 2025/183127 A1

(51) 国際特許分類:
B29C 59/02 (2006.01) *C08L 83/07* (2006.01)
C08L 83/05 (2006.01)

(21) 国際出願番号： PCT/JP2025/007008

(22) 国際出願日： 2025年2月27日(27.02.2025)

(25) 国際出願の言語： 日本語

(26) 国際公開の言語： 日本語

(30) 優先権データ：
特願 2024-031743 2024年3月1日(01.03.2024) JP

(71) 出願人: 信越化学工業株式会社(**SHIN-ETSU CHEMICAL CO.,LTD**) [JP/JP]; 〒1000005 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 (JP). ＳＣＩＶＡＸ株式会社(**SCIVAX CORPORATION**) [JP/JP]; 〒2120032 神奈川県川崎市幸区新川崎７番７号 (JP).

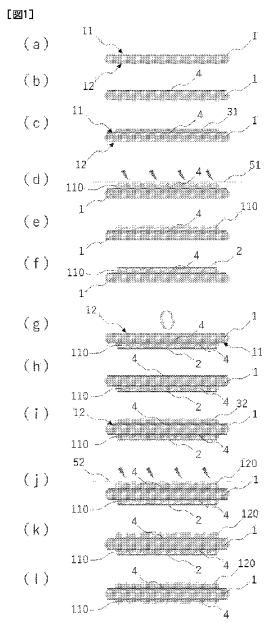
(72) 発明者: 大竹 滉平(**OTAKE Kohei**); 〒2120032 神奈川県川崎市幸区新川崎７番７号ＳＣＩＶＡＸ株式会社内 (JP). 田中 覚(**TANAKA Satoru**); 〒2120032 神奈川県川崎市幸区新川崎７番７号ＳＣＩＶＡＸ株式会社内 (JP). 小川 敬典(**OGAWA Yoshinori**); 〒1000005 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号信越化学工業株式会社本社内 (JP). 北川 太一(**KITAGAWA Taichi**); 〒3790224 群馬県安中市松井田町人見１番地１０信越化学工業株式会社シリコーン電子材料技術研究所内 (JP).

(74) 代理人: 奥田 律次 (**OKUDA Noritsugu**); 〒3020110 茨城県守谷市百合ヶ丘１－２３５４－４３０ (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL,

(54) **Title:** DOUBLE-SIDED MOLDING METHOD AND MOLDED PRODUCT

(54) 発明の名称： 両面成型方法および成型品



(57) **Abstract:** The purpose of the present invention is to provide: a double-sided molding method using a protective film that, during processing, does not detach from a resin pattern to be protected, does not cause any defects, and does not generate any adhesive residues when the protective film is detached; and a molded product obtained thereby. A double-sided molding method for forming a first resin pattern 110 on a first surface 11 of a substrate 1 and forming a second resin pattern 120 on a second surface 12 of the substrate 1 comprises: a protective film pasting step for pasting a silicone rubber layer side of a protective film 2 having the silicone rubber layer on the first resin pattern 110; and a second resin pattern molding step for forming a second resin pattern 120 on the second surface 12 after the protective film pasting step.

(57) 要約：プロセス中に保護対象の樹脂パターンから剥離せず、欠陥を発生させないとともに、保護フィルムの剥離時に糊残りが発生しない保護フィルムを用いた両面成型方法およびその成形品を提供することを目的とする。 基板１の第１の面11に第１樹脂パターン110を形成し、当該基板１の第２の面12に第２樹脂パターン120を形成するための両面成型方法であって、シリコーンゴム層を有する保護フィルム２の当該シリコーンゴム層側を、第１樹脂パターン110上に貼付する保護フィルム貼付工程と、保護フィルム貼付工程後に、第２の面12に第２樹脂パターン120を形成する第２樹脂パターン成型工程と、を有する。

WO 2025/183127 A1

［続葉有］

PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UY, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国（表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能）：ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類：

— 国際調査報告（条約第21条(3)）

— 補正された請求の範囲及び説明書（条約第19条(1)）